

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-126350

(43) 公開日 平成7年(1995)5月16日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	序内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 8 G 59/32	N H W			
59/20	N J W			
H 0 5 K 1/03		G 7011-4E		
// B 3 2 B 15/08	J			

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全4頁)

(21) 出願番号	特願平5-296130	(71) 出願人	390022415 東芝ケミカル株式会社 東京都港区新橋3丁目3番9号
(22) 出願日	平成5年(1993)11月1日	(72) 発明者	渡輪 努 神奈川県川崎市川崎区千鳥町9番2号 東 芝ケミカル株式会社千鳥町工場内
		(74) 代理人	弁理士 諸田 英二

(54) 【発明の名称】 無溶剤エポキシ樹脂組成物及びそれを用いたプリプレグ、銅張積層板

(57) 【要約】

【構成】 本発明は、(A)ビスフェノールA型エポキシ樹脂、(B)エポキシアクリレート樹脂、(C)重合開始剤および(D)硬化剤を必須成分としてなることを特徴とし、樹脂組成物に対して前記(B)のエポキシアクリレート樹脂を30～70重量%の割合で含有してなり、プリプレグの含浸に用いる無溶剤エポキシ樹脂組成物である。そして、これを用いガラス基材に含浸し紫外線照射し半硬化状にしてなるプリプレグおよび該プリプレグを使用した銅張積層板である。

【効果】 本発明の無溶剤エポキシ樹脂組成物は含浸性に優れ、これを用いたプリプレグ、銅張積層板は、半田耐熱性、耐ミーズリング性等に優れたもので、溶剤除去に伴う悪影響がない。

Best Available Copy